

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 券商策略会
参与机构	华泰宝兴、财通基金、华夏基金、信诚基金、华宝基金、西部利得基金、招银理财、广发资管、睿亿投资、峰境基金、外贸信托、万向创投、博衍基金、世嘉控股、国泰基金、上海国有资产经营有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、承风金萍私募、上海标朴投资、鑫巢资本、榕湖投资、苏银理财、开思基金、浙商资管、易知投资、百年人寿、宁波盛世知己投资、上海保银、深圳君茂投资、苏州龙远投资、上海联创永沂投资、江苏乾融、中信证券、中金证券、申银万国、国泰海通、瑞银证券、摩根大通、国投证券、浙商证券、方正证券、东海证券、东方证券、华金证券、上海证券、中信建投证券、国金证券、华安证券、国信证券、华福证券、国信证券、国盛证券、华鑫证券、国联证券、中航证券、东兴证券	
时间	2025 年 4-5 月	
地点	现场会议、电话会议	
上市公司接待人员姓名	董事长蒋渊，副总经理陆磊，董秘任慕华，财务总监丁炯	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、 公司 2024 年度及 2025 年一季度业绩情况介绍</b></p> <p>公司 2024 年度实现收入 36.05 亿元，同比增长了 14.4%；归母净利润约 2,360 万元，同比下降较多。2025 年一季度实现收入 7.28 亿元，净利润 1,902 万元。近年来公司经营性现金流一直是流出状态，2023 年度流出约 8 亿元，2024 年度流出约 4.6 亿元，2025 年一季度流出约 6,200 万，公司一直在加强对现金流的管理，</p>	

已取得初步成效。

## 二、 交流的主要问题及回复概要

### 1、请公司高纯工艺业务发展如何，目前市占率多少？

答：公司系统集成及支持设备国内龙头地位稳固，公司系统集成及支持设备已经能够实现 ppb（十亿分之一）级的不纯物控制，核心技术强于国内竞争者，在用户应用需求牵引下开发的个别功能超越国际品牌。公司已经成为国内高纯工艺系统支持设备供应商，自主品牌 SAFETRON®目前业务量接近系统集成业务总量的 40%，至今已经出货各类高纯特气设备和高纯化学品设备超过 3.6 万台，其中 2024 年出货超过 1 万台，有效替代并改变了原先由境外公司垄断的供给格局。

据公司统计，2016-2024 年中国大陆主流 12 寸晶圆厂 41 次特气中标结果中，公司气体设备及系统的市占率是 48.8%，化学品设备及系统的市占率超过 30%。在为诸多一线 12 寸晶圆厂服务的过程中，公司积累了大量的技术和经验，并结合自身模块化+数字化的优势，推出了场景化解决方案，为用户在 COC 及 COO 的优势上作出贡献，这将进一步巩固公司在高纯领域的领先地位。

### 2、公司湿法设备业务有何进展？未来发展趋势如何？

答：2024 年公司对设备进行技术升级，优化改造，公司旗下至微科技发布了 S300-D 湿法设备新平台，该平台专为先进制程需求设计，覆盖 SPM、BACKSIDE ETCH（背面蚀刻）、Pre clean（预清洗）、BEVEL（斜边处理）等关键工艺，其 WPH（每小时处理晶圆的数量）提升 30%，新平台显著提升了生产效率，并在腔体的缩小和流场的控制方面有了进一步提升以满足更苛刻的工艺需求。

公司于 2022 年正式推出的高温硫酸 SPM 设备，成为国产首台应用于大规模量产线的 12 英寸硫酸清洗机，月产能最高可达 6 万片次，截至 2024 年末单机累计产量超过 70 万片次，是高阶

湿法设备国产替代进口的重要里程碑。

未来公司将聚焦先进制程的产品与服务，把握好目前先进制程湿法工艺验证领先的优势，希望在下游集成电路客户先进制程有重大进展时抓住机遇，提升公司半导体设备业务比重。

### **3、公司湿法设备能替代国外进口的设备吗？**

答：公司湿法设备用户已经覆盖大部分核心客户并为其配套关键工艺节点的湿法工艺设备。在 28 纳米率先实现前中后段全工艺覆盖，在更先进制程节点正陆续替代国外厂商。公司不仅实现了工艺机台的全自主 IP，还实现了核心模组到元器件层的本土供应链培育和建设。

### **4、公司研发投入近几年来一直在增长，2024 年达到了 4.42 亿，请问公司在哪些方面进行了研发？**

答：公司的研发投入从 2017 年的 0.13 亿元跃升至 2024 年的 4.42 亿元。过去五年累计研发投入超过 15 亿元。

公司上市初期，公司研发集中在高纯设备品类拓展的研发，以及湿法设备的槽式机台；从 2019 年以来集团投入研发费用最大的是湿法单片设备，覆盖前中后段全部湿法工艺。

高纯设备的高性能及全品类使公司在高纯领域成为头部企业，以特气为例，2016 年以前该领域 12 寸晶圆厂 100%由四家外企和一家台湾地区企业垄断，2016 年至 2024 年间中国大陆的 41 个重要大项目近半数由公司得标，占比 48.8%。而四家外企和一家台企总共占比已经只有 36%。公司完成了该类设备及系统的全面国产替代，服务了产业高速发展。

在集成电路卡脖子的湿法设备产品上，公司自 2020 年来，持续加大研发投入，主要用于国内更先进制程节点。难点设备的研发需要更久的时间更大的投入，目前产品已经取得了阶段性的突破，正在客户端进行湿法设备的验证，同时获得了国内极少数更先进制程节点用户的十数台设备，均已陆续完成研发并交付中。

前期的研发投入及验证支撑公司每年新签订单的增长，专利数量从上市前的 50 余项增长至 2024 年末的 845 项，且近半数为发明专利。截至 2024 年末，公司累计申请专利 845 件（其中发明专利 350 件），已授权专利 577 件（其中发明专利 182 件），软件著作权 185 件，注册商标 152 件。

**5、请问公司湿法设备零部件中，自产自用的比例大概在多少？**

答：公司自 2020 年 8 月起即启动去美方案，2021 年开始持续进行在地化供应链建设，保证供应链稳定，基本实现自主可控，通过订单牵引、合作开发等一系列举措培养本土供应链的阶段目标已陆续达成。目前尚有部分分析、侦测类部件还在持续验证中，公司也很早就有充足的备货并实施仪表类涉美替代方案。

以公司 S300D 产品为例，整个设备涉及上万个部件，按部件数量统计目前已经做到 70%-80%在地化。

**7、电子材料业务 2024 年盈利情况如何？**

答：公司大宗气站的新业务拓展进程顺利。由公司投资和设计的国内首座完全国产化的 12 英寸晶圆对应 28 纳米的大宗气体供应工厂指标完全达标，为用户提供至少 15 年的高纯大宗气体供应，从 2022 年初至今持续稳定运行，成功打破了半导体级大宗气由国际供应商垄断的格局，实现了该制程节点国内自主大宗气站零的突破。目前公司第二座大宗气站于 2024 年上半年已开始为客户提供供气服务。2024 年度，公司电子材料营业收入 1.64 亿元，同比增长 165.09%。随着客户的产能爬升，大宗气站将为公司贡献稳定可观的营收。

**8、公司之后的盈利有什么增长点？**

答：您好，公司一直专注在半导体领域围绕“工艺-设备-材料”三位一体发展，目前湿法工艺机台开发响应先进制程节点需求，持续跟动国内头部集成电路客户进行更先进制程的研发，成为国内领先的核心工艺设备及系统专业供应商。公司始终关注产业下

游核心企业稳定运营阶段的商业机会，布局黏度更高的电子材料、专有服务等业务板块，并初见成效。

**9、收购威顿晶磷目前进展如何？**

答：本次收购威顿事项涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在稳步推进当中，公司持续推进本次交易的相关工作并将在相关工作完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项并公告。

**10、当前供应链备货和技术替代方案能否支撑长期业务连续性？是否有进一步多元化布局的计划？**

答：公司 2020 年 8 月起启动设备全面去 A 并于 2021 年中达成，可以供应被无端制裁企业。公司 2021 年中开始持续进行在地化供应链建设，保证供应链稳定，以实现自主可控。公司通过订单牵引、合作开发、战略投资等一系列举措培养本土供应链的阶段目标已陆续达成并能支持公司业务持续发展。

公司认为国家集成电路制造产业尤其是设备材料领域正从量变到质变，目前行业已进入精细化发展阶段，结构性的机遇和挑战符合公司战略研讨时的预判。过去数年产业经历了高度关注并带来持续的资源流入，可谓水大鱼大，成就了一批企业的成长；而接下来行业的攻坚阶段，关注度和资源流入均平缓，恰是到了水落石出的时候，有愿力有能力和扎实前行的企业才能真正强大。公司始终根据下游行业的发展变化去假设产业终局，在战略布局中高度关注行业周期，始终以抓住集成电路产业大力发展的机遇为重，业务重心围绕覆盖用户资本性开支和运营阶段开支相关的不同生命周期产品线展开。所以公司战略中特别重投入半导体设备领域以获得极难得的战略机遇，而长期上公司又始终关注产业下游核心企业稳定运营阶段的商业机会，布局粘度更高、周期更长的电子材料、专有服务等业务板块且初见成效。

**11、请问贵司采取了哪些举措来降低财务费用、改善经营性现金流？**

答：公司近年来财务费用增长主要缘于经营需要所需的资金投入；公司通过预算管控、加强应收账款回款、节约各类成本等方法降低财务费用、管理费用，并积极探索拓宽融资渠道，同时公司仍在进一步落实措施以降低各类费用。

近年现金流为负主要系叠加了研发高投入、长交期规模备货、在地化供应链建设、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机等现金流高流出期。随着公司产品逐渐通过验证并形成批量销售、持续的在地化供应链建设取得成效，最大的平台级别的研发高投入期趋缓，电子材料类现金流业务占比提升，未来公司经营性现金流将持续得到改善。

### **12、行业以后的发展前景怎样？**

答：您好，公司认为目前行业已进入精细化发展阶段，且随着下游客户在制程节点上的分化，未来公司将聚焦先进制程的产品与服务。